17p-B2-3

## 高濃度ドープによる CNT/SiC 界面の接触抵抗の低減

Reduction of the contact resistivity at CNT/SiC interface by heavy doping

早稲田大理工<sup>1</sup>,名古屋大エコトピア研<sup>2</sup>,<sup>○</sup>鈴木和真<sup>1</sup>,稲葉優文<sup>1</sup>,渋谷恵<sup>1</sup>,

明道三穂1,平岩篤1,増田佳穂2,乗松航2,楠美智子2,川原田洋1

Waseda Univ.<sup>1</sup>, Nagoya Univ.<sup>2</sup>, <sup>°</sup>Kazuma Suzuki<sup>1</sup>, Masafumi Inaba<sup>1</sup>, Megumi Shibuya<sup>1</sup>, Miho Myodo<sup>1</sup>,

Atsushi Hiraiwa<sup>1</sup>, Yoshiho Masuda<sup>2</sup>, Wataru Norimatsu<sup>2</sup>, Michiko Kusunoki<sup>2</sup>, Hiroshi Kawarada<sup>1</sup>

E-mail: gloria-274@asagi.waseda.jp

## 1. CNTフォレストのSiCパワーデバイス応用

SiC表面分解法<sup>[1,2]</sup>で作成した高密度垂直配向CNTs (CNT on SiC) は、~10<sup>13</sup> cm<sup>-2</sup>もの非常に高い本数密度の稠密なCNTフォレストであり、その高い熱伝 導率と併せて、CNTを高電流密度用電極として用いる場合に理想的である。 CNT/SiC界面の接触抵抗の評価がパワーデバイスへのCNTフォレスト電極応 用に不可欠である。今回、10<sup>18</sup> cm<sup>-3</sup>程度の窒素高濃度ドープSiCとCNTとの接 触抵抗とSchottky障壁を調査したので報告する。

## 2. CNT/SiC 界面の接触抵抗評価

n型4H-SiC基板(抵抗率:  $4\times10^2 \Omega$ cm)を $10^2$ Pa程度の真空中で1700 °C で加熱して CNT on SiC を形成し、図1のような測定系にて電気測定を行 った。一般に CVD 法による垂直配向 CNT フォレストは伝導率の異方性が 高く、水平方向には CNT-CNT 間の隙間で電気伝導率が低い。しかし、CNT on SiC は稠密な CNT フォレストであり、CNT-CNT 間にグラファイトシー トが存在するために軸に垂直な方向にも比較的高い伝導率を持つため CNT フォレストの水平方向にも伝導する。このため、伝導面積を変化して 抵抗測定することで CNT-SiC の接触抵抗成分を分離することができる。 図1の抵抗値と伝導面積の逆数の関係から CNT/SiC 界面の接触抵抗を見 積もり、これを図2に CNT 長毎にプロットした。CNT 長が増加するにつ れて接触抵抗が増加するようにみえるが、CNT on SiC の場合、CNT が長く成 長すると、CNT/SiC 界面で界面に平行なグラファイト層(図2右側)が形成 されるためと考えられる。

導電性 AFM による電流-電圧測定から SiC 基板のドナー濃度ごとの接触 抵抗を評価したところ、CNT/SiC 界面の接触抵抗はドープ濃度~1×10<sup>18</sup> cm<sup>-3</sup> のとき~1×10<sup>-2</sup>  $\Omega$ cm<sup>2</sup>、5×10<sup>17</sup> cm<sup>-3</sup> のとき~3×10<sup>-2</sup>  $\Omega$ cm<sup>2</sup> と見積もられた。 式(1)に接触抵抗の Schottky 障壁高さとドープ濃度に対する依存性を示す。

$$R_{C} = \frac{k\sqrt{E_{00}}\cosh(E_{00}/kT)\coth(E_{00}/kT)}{A^{**}Tq\sqrt{\pi q(\phi_{Bn} - \phi_{n})}}\exp\left[\frac{q(\phi_{Bn} - \phi_{n})}{E_{00}\coth(E_{00}/kT)} + \frac{q\phi_{n}}{kT}\right]\cdots(1)$$









この理論曲線と基板のドープ濃度が  $1 \times 10^{18}$  cm<sup>-3</sup>、 $5 \times 10^{17}$  cm<sup>-3</sup>のときの接触抵 抗をプロットしたものが図 3 である。基板の窒素ドナー密度が増加すると Schottky 障壁が薄くなりトンネル電流 が増加し、CNT/SiC 界面の接触抵抗は減少する。今回得られた 2 点の接触抵抗は式(1)にて Schottky 障壁高さ 0.5 eV でフィッティング(実線)される。この障壁高さは SiC では非常に低いものであり、CNT がドープ濃度  $10^{19}$  cm<sup>-3</sup> 以上の 4H-SiC で良好なオーミック電極になり得ることを示している。 1. M. Kusunoki *et al.*, *Appl. Phys. Lett.*77, 531 (2000)

2. M. Kusunoki et al., Appl. Phys. Lett. 87, 103105 (2005)